

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2021-103

## 北京赛微电子股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	刘波	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室	
电话	010-82252103	010-82251527	
电子信箱	zhangabin@smeiic.com	lb@smeiic.com	

#### 2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	394,837,209.69	359,792,013.78	9.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,064,145.07	11,706,824.25	515.57%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,490,592.03	7,071,128.32	-177.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,166,374.62	41,798,984.26	-241.55%
基本每股收益（元/股）	0.1128	0.0182	519.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1128	0.0182	519.78%
加权平均净资产收益率	2.37%	0.41%	1.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,940,892,187.79	4,775,820,168.84	3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,989,232,577.40	3,082,849,283.84	-3.04%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	46,672	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	38.39%	245,367,035	184,025,276	质押	124,377,071
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	13.83%	88,362,101	88,362,101		
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	9,775,433	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	7,374,335	0		
刘琼	境内自然人	0.82%	5,250,972	0		
苏颜翔	境内自然人	0.73%	4,677,680	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	4,380,600	0		
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 75 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,000,000	0		
广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 73 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,000,000	0		
李纪华	境内自然人	0.45%	2,898,296	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、刘琼、李纪华之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东苏颜翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,677,680 股，实际合计持有 4,677,680 股；公司股东广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新 73 号私募证券投资基金通过普通证					

	券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股；公司股东广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 75 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股；
--	--

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### 三、重要事项

#### （一）整体经营情况及利润结构

报告期内，公司半导体业务继续快速发展，尤其主营业务 MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及持续扩张的 8 英寸成熟产能，较好地把握了下游生物医疗、通讯、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，订单饱满，生产与销售旺盛。在 COVID-19 疫情全球肆虐的背景下，公司 MEMS 业务克服了各种困难，在本报告期内继续实现了增长。其中，瑞典 MEMS 产线继续保持了强劲的盈利能力；而由于在本报告期继续面临较大的折旧摊销压力、工厂运转及人员费用持续增长，且在本报告期末一期产能刚刚开始正式生产，公司新建成的北京 MEMS 产线发生较大亏损，对本报告期 MEMS 业务的整体财务结果构成了较大的负向影响。GaN 作为新兴业务继续加快布局，为下一步实现发展积累基础，虽然已签署批量订单，但在报告期末仅完成少量交付、尚未形成规模收入及利润。公司为把握市场机遇，增加了半导体业务的资本投入和人员招聘，保障核心业务 MEMS 和潜力业务 GaN（氮化镓）所需的发展资源，本报告期内相关管理费用增长，相关财务及研发费用大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 39,483.72 万元，较上年同期增长 9.74%；实现营业利润 7,911.22 万元，较上年同期大幅增长 472.16%；实现利润总额 7,911.11 万元，较上年同期大幅增长 470.72%；实现净利润 4,680.58 万元，较上年同期大幅增长 3,262.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,206.41 万元，较上年同期大幅增长 515.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-549.06 万元，较上年同期大幅下降 177.65%。报告期内，公司基本每股收益 0.11 元，较上年同期

上升 519.78%；加权平均净资产收益率 2.37%，较上年同期提高 1.96%（绝对数值变动），主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比上升 515.57%。本报告期末，公司总资产 494,089.22 万元，较期初基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益 298,923.26 万元，股本 639,121,537 元，归属于上市公司股东的每股净资产 4.68 元，较期初基本持平。

与此同时，近年来，公司陆续取得系列政府补助，其中部分补助在本报告期内补偿了部分相关成本费用或损失，公司报告期内确认的政府补助金额为 5,665.81 万元，占当期营业利润的 71.62%；近年来，公司围绕主业开展了系列产业投资布局，其中部分投资（如在半导体基金的投资）在本报告期内继续实现投资项目退出或首次出让部分股权，公司报告期内确认的投资收益为 4,046.94 万元，占当期营业利润的 51.15%。

从业务角度，公司报告期内的利润构成及来源更加依赖于半导体业务，尤其是 MEMS 业务；从财务科目角度，公司报告期内源自主营业务的经常性利润因所处发展阶段而出现暂时性大幅下降，而因政府补助、投资收益所形成的非经常性利润大幅增长，本报告期的利润构成及来源发生重大变动。

## （二）各主要业务情况

### 1、MEMS 业务开启新纪元

报告期内，在 COVID-19 疫情持续、国际供应链面临挑战的背景下，瑞典 MEMS 产线正常运转并继续适度扩产，努力推进新增产能爬坡，本报告期实现收入 36,108.59 万元，较上年增长 14.44%，其中，MEMS 晶圆制造实现收入 25,485.31 万元，较上年同期增长 26.88%；MEMS 工艺开发实现收入 10,623.28 万元，较上年同期减少 7.34%，主要是因为在下游客户需求持续扩张的背景下，瑞典 MEMS 产线受限于产能扩张的总容量与新增产能的投入进度，只能部分满足下游客户的需求；公司瑞典 MEMS 产线在 2020 年第三季度完成升级扩产后自第四季度起继续加大资本投入扩产，在报告期内处于新增产能磨合期，产能利用率仅达到 61.33%；其中在晶圆制造业务存在刚性交付要求的情况下，工艺开发业务的产能分配受到一定挤占，而部分工艺开发客户更是愿意为单片晶圆支付较高的价格。报告期内，公司 MEMS 业务综合毛利率达到 47.19%，较上年同期继续提升 2.08%，公司 MEMS 晶圆单价高达约为 3,600 美元/片，主要是由于在产能紧张、业务充足的情况下，公司可以享受优渥的价格和支付条件；同时，为服务于长期业务规划，公司筛选承接 MEMS 晶圆制造及工艺开发业务，使得即使在新增产能陆续投入使用、相关折旧及人工成本上升的情况下，瑞典 MEMS 产线的业务仍实现了较高的毛利率，尤其是 MEMS 工艺开发业务，其中公司仅为硅光子、光刻机两家厂商的收入就超过了工艺开发总收入的 50%，但交付晶圆数量少、毛利率高。

报告期内，公司控股子公司赛莱克斯北京建设的北京 MEMS 产线一期 1 万片/月产能正式启动批量商业化生产，其代工生产的首批 MEMS 麦克风芯片通过客户认证，经过对该批次芯片进行晶圆级性能测试以及对基于该芯片封装的 MEMS 麦克风进行性能检测和可靠性验证，产自北京 FAB3 芯片的性能、良率均达到设计指标要求，且与公司瑞典 FAB 同类产品相当。随着北京 MEMS 产线所服务客户和产品数量的持续增加、标准化规模产能的陆续释放，公司 MEMS 业务将开启新纪元。

报告期内，得益于 MEMS 应用市场的高景气度，并基于持续扩充产能的瑞典产线及北京产线，公司积极开拓全球尤其是亚洲市场，并积极承接生物医疗、通讯、工业汽车、消费电子等领域厂商的工艺开发及晶圆制造订单，继续服务全球 DNA/RNA 测序仪巨头、全球硅光子器件领先厂商、全球光刻机巨头、全球网络搜索引擎巨头、全球医疗设备领先厂商、全球网络通信和应用巨头以及工业和消费细分行业的领先企业。截至本报告期末，公司 MEMS 业务拥有的长期供货合同/具体待执行订单金额合计超过 10 亿元，若得以顺利执行，将持续具备充足的业务增长动力。

报告期内，公司升级改造后的瑞典产线陆续投入使用，且继续添购部分设备，主要面向北美及欧洲的工艺开发及晶圆制造业务保障能力得到加强；同时公司继续与国家集成电路基金共同投入，公司控股子公司赛莱克斯北京进一步完善核心管理及人才团队，实现北京“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”一期产能的正式投产，开始向亚洲及全球客户提供世界级、高标准 MEMS 工艺开发及晶圆制造规模产能。公司瑞典与北京 MEMS 产线的协同互补将有力保证公司继续保持在 MEMS 纯代工领域的全球领先地位。

### 2、GaN 业务持续布局并突破

报告期内，公司 GaN 业务积极推进，在 GaN 外延材料方面，公司基于自身掌握的业界领先的 8 英寸硅基 GaN 外延与 6 英寸碳化硅基 GaN 外延生长技术，积极展开与下游全球知名晶圆制造厂商、半导体设备厂商、芯片设计公司以及高校、科研机构等的合作并进行交互验证，开始签订 GaN 外延晶圆的批量销售合同并陆续交付；在 GaN 芯片方面，公司已陆续研发、推出不同规格的功率芯片产品及应用方案，已推出数款 GaN 功率芯片产品并进入小批量试产，与知名电源、家电及通讯企业展开合作，进行芯片系统级验证和测试，开始签订 GaN 芯片的批量销售合同并陆续交付，并寻求长期稳定的产业链合作伙伴；同时积极推动微波芯片的研发工作。报告期内，公司 GaN 业务实现收入 149.87 万元，毛利率达 67.92%。截至报告期末，公司 GaN 业务已累计签订超过 3,000 万元人民币的销售合同并根据商业条款陆续安排生产及交付。

报告期内，公司持续布局 GaN 产业链，以参股方式建设 GaN 芯片制造产线，积极推动技术、工艺、产品积累，以满足下一代功率与微波电子芯片对于大尺寸、高质量、高一一致性、高可靠性 GaN 外延材料以及 GaN 芯片的需求，努力为 5G 通讯、云计算、新型消费电子、智能白电、新能源汽车等领域提供核心部件的材料保障及芯片配套。

### （三）研发情况

公司一直重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司聚焦发展的半导体业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，需要公司进行重点、持续的研发投入。近年来，公司一直保持着较高的研发投入水平和强度，2018-2020 年的研发费用分别为 5,430.05 万元、11,048.47 万元、19,536.82 万元，占当年营业收入的比例分别为 7.62%、15.39%、25.54%。报告期内，结合半导体业务长远发展的需要，公司继续大力推进 MEMS 工艺开发技术、MEMS 晶圆制造技术、GaN 外延材料生长工艺技术、GaN 芯片及应用设计技术等研发，2021 年上半年共计投入研发费用 13,522.84 万元，较上年同期增长 94.95%，占营业收入的比重高达 34.25%，研发投入规模和强度呈现出极高的水平。

### （四）投融资情况

报告期内，为更好地服务于主业发展，公司根据长期发展战略继续积极开展投融资活动：（1）股权融资方面，公司继续推动拟向特定对象发行股票融资不超过 23.45 亿元事项，于 1 月获深交所上市审核中心审核通过，于 3 月取得中国证监会出具的同意批复，公司持续与一批看好在万物互联与后摩尔时代中 MEMS、GaN 产业未来发展的各类资本与投资者就公司本次融资事项保持沟通，积极推进相关工作；（2）业务剥离方面，延续发展战略重大调整、资源聚焦半导体业务的需要，公司继续剥离剩余部分导航业务，出售耐威时代 100% 股权、对中测耐威进行减资；（3）股权调整方面，积极推动重点业务子公司的架构调整及股权融资、支持旗下控股子公司融资，如收购瑞典 Silex 少数股权、调整聚能创芯股权结构并推进融资、转让所持中科昊芯部分股权、支持光谷信息申请精选层挂牌；（4）新增投资方面，根据发展需要投资新设业务子公司、继续实施针对企业与基金的相关产业投资，如投资设立聚能国际、对爱集微进行增资、投资设立火眼基金；（5）产业基金方面，公司继续跟踪半导体产业基金、北斗产业基金的投资与投后情况，继续关注赛微私募基金的运行；（6）融资租赁方面，瑞典 Silex 与赛莱克斯北京继续执行相关融资租赁交易；（7）日常融资方面，公司银行授信融资活动正常开展。

报告期内，公司共实现投资收益 4,046.94 万元，其中处置长期股权投资的投资收益 4,490.47 万元，权益法核算的长期股权投资-443.53 万元。具体明细如下：

单位：万元

<b>投资收益总额</b>	4,046.94
<b>投资处置收益</b>	4,490.47
其中：	
青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）	3,261.95
北京中科昊芯科技有限公司	1,140.23
哈尔滨船海智能装备科技有限公司	88.29
<b>持有股权收益</b>	-443.53
其中：	
武汉光谷信息技术股份有限公司	-442.62
湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	255.17

北京中科昊芯科技有限公司	-173.09
广州联星科技有限公司	-17.23
北京赛微私募基金管理有限公司	-65.77

#### （五）整体发展战略

自成立以来，公司以传感终端应用为起点，通过内生发展及外延并购成功将业务向产业链上游延伸拓展，且 MEMS 工艺开发及晶圆制造已逐渐成为公司的主要业务。基于对 MEMS 与 GaN 产业发展前景的判断，且受囿于复杂的国际政治经济环境，公司对长期发展战略作出重大调整，继续剥离非半导体业务，集中资源，形成以半导体为核心的业务格局，MEMS、GaN 成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务。与此同时，公司围绕主要业务开展了一系列产业投资布局，直接或通过产业基金对产业链相关企业进行参股型投资。公司的发展目标是致力于成为一家立足本土、国际化发展的知名半导体科技企业集团。